

Hispack 2006

La decimotercera edición del Salón Internacional del Embalaje se celebrará del 27 al 31 de marzo de 2006

Hispack define Nuevos Retos para Revalidar su Crecimiento en la Convocatoria de 2006

La organización potenciará la dimensión internacional del certamen
Un encuentro científico tecnológico con reconocidos
ponentes del sector aportará la visión más actualizada de la I+D+I
de la industria del packaging
El salón dispondrá de más de 125.000 m² brutos
de exposición en el recinto Gran Vía M2 de
Fira de Barcelona

Tiempo de lectura: 12 min.

Javier Riera-Marsa, nombrado nuevo presidente del Comité Organizador

Con la reciente constitución del nuevo Comité Organizador, que preside por primera vez, Javier Riera-Marsa, el **Salón Internacional del Embalaje, Hispack**, inicia los preparativos para su próxima edición, la cual se celebrará del 27 al 31 de marzo de 2006 en el recinto Gran Vía M2 de Fira de Barcelona. En su próxima convocatoria, Hispack se ha marcado nuevos retos como el aumento de su dimensión internacional y la organización de un encuentro científico tecnológico, con el fin de revalidar su crecimiento y su condición de referente sectorial. Estos objetivos -junto al cambio de periodicidad que pasa a ser trienal y a la disponibilidad de mayor espacio en el recinto ferial-, se suman a la proyección y mejora de iniciativas anteriores que hoy for-

man parte de la propia identidad del salón y que convierten a Hispack en un salón sin límites.

La oferta

Hispack 2006 podrá ocupar los cuatro pabellones del recinto Gran Vía M2, en total más de 125.000 m² brutos de exposición (que representan 65.000 m² netos de stands). Gracias a ello, el salón contará con espacio suficiente para continuar con su crecimiento histórico. Los sectores de actividad que estarán presentes en Hispack serán: Maquinaria y accesorios de Envase y Embalaje; Maquinaria y equipos de embotellado; Maquinaria para etiquetado, codificación y marcado; Maquinaria para procesos de fabricación de productos a envasar; Materias primas; Materiales y medios de Envase y Embalaje; Productos auxiliares; P.L.V. Publicidad en el Lugar de Venta; Logística. Manipulación,

almacenamiento y distribución. Medio ambiente. Recuperación, Tratamiento y Reciclado; Empresas de Consultoría, Ingeniería y Servicios afines.

Como se recordará, el traslado del salón del recinto de Montjuïc al de Gran Vía M2 en la edición de 2003 constituyó un importante paso adelante para mejorar la calidad de servicio del salón hacia sus expositores y visitantes. El nuevo emplazamiento es uno de los recintos feriales más modernos de Europa.

Un salón más internacional

El **Salón Internacional del Embalaje** se encuentra entre las cuatro ferias europeas más importantes de envase y embalaje y en los últimos años ha ido ganando poder de convocatoria internacional, aumentando tanto el número de empresas extranjeras participantes como el de

visitantes profesionales de otros países.

Sin embargo, tal como explica el presidente del Comité Organizador, Javier Riera Marsa, "la proyección internacional del salón y su capacidad de atraer empresas y compradores es todavía insuficiente respecto a las demandas y necesidades del sector, y también respecto a las propias exigencias de la organización". Para Riera-Marsa "buena parte del crecimiento de Hispack pasa por su mayor presencia internacional y, conscientes de ello, se van a dedicar esfuerzos y recursos para conseguir este objetivo".

En este sentido, la internacionalización será uno de los principales ejes de actuación para la próxima edición del salón, de manera que Hispack sea un referente para los mercados naturales de exportación del sector y, a la vez, sea un punto de atracción de mercados potenciales que incrementen la dimensión de la feria.

Por todo ello, el Comité Organizador ha creado una comisión interna de trabajo encargada de fijar la estrategia de promoción internacional e identificar los mercados de interés para el sector, así como las acciones a desarrollar. En esta comisión colabora activamente Amec-Envasgraf.

En esta edición, Hispack acogerá encuentros de carácter científico y tecnológico dedicados básicamente a debatir los aspectos más revolucionarios y actuales de la aplicación de I+D en las empresas del sector. El programa de las sesiones incluirá diferentes ponencias pronunciadas por reconocidos expertos nacionales y extranjeros que desarrollan su actividad en esta industria.

Según Riera-Marsa, el nuevo valor agregado que supone la organización de estos encuentros hará que Hispack, una vez más, "contribuya al conocimiento y a la formación

del sector, convirtiéndose en el marco ideal para que la industria del envase y el embalaje, no sólo española sino internacional, estudie y analice con el máximo rigor los aspectos técnicos, tecnológicos y científicos que soportan su producción actual y determinan sus futuras tendencias". El presidente de Hispack asegura que "gracias a este evento el salón será un foro internacional ineludible para el debate científico del sector, prestigioso por sus contenidos y por sus participantes".

Actividades que configuran la identidad del salón Hispack, promotor de los beneficios y la cultura del packaging

En los últimos años, con la progresiva incorporación de nuevas propuestas de tipo histórico, cultural, sociológico, o económico a la exhibición estrictamente comercial del certamen, Hispack se propone completar su oferta y cobertura sectorial, asumiendo aspectos y actuaciones complementarias al proceso técnico-comercial del envase y el embalaje y convirtiéndose en un instrumento de reflexión de cara al envase del futuro y a su evolución mercadológica. Estas iniciativas se han instituido, como decíamos, en un rasgo más de la identidad del certamen.

En el año 2006, el salón que organiza Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación Graphispack volverá a convocar el Concurso Nacional de Líderes de Envase y Embalaje, **Líderpack**, que llega a su sexta edición. Los Premios Líderpack reconocen el mérito y la calidad de los aportes e innovaciones españolas producidas en diferentes áreas relacionadas con el mundo del envase y el embalaje y la PLV. Estos premios son el pasaporte para participar en los WorldStars, la más acreditada competencia mundial de la industria del packaging, en la que los envases españoles suelen cosechar un gran éxito. En las últimas tres ediciones casi una veintena de

productos españoles consiguieron un WorldStar.

Otra de las iniciativas de Hispack que persigue proyectar la importancia del envase y embalaje en la vertiente social y cultural es el **espacio de exposición denominado "Pack. Historia, Memoria y Cultura del Packaging"**, inaugurado en 1997 que hasta el momento ha albergado cuatro exposiciones. La primera de ellas se dedicó a documentar, desde diversas perspectivas, una selección de los doce envases más célebres de la historia reciente del consumo español. En 1999, se mostraron los avances más significativos en el mundo del envase durante el siglo XX. En 2001 se exhibieron "6 colecciones de packaging" provenientes de varios museos españoles y entidades privadas, con el fin de descubrir el creciente valor del envase en el mundo del coleccionismo; y en 2003 se optó por destacar la presencia del packaging en el arte contemporáneo. Hispack volverá a acoger en su espacio cultural **"Pack. Historia, Memoria y Cultura del Packaging"** una nueva exposición que volverá a proyectar la importancia del envase y embalaje en la vertiente social y cultural. El tema en torno al que girará la exposición se dará a conocer próximamente.

Cabe destacar también el aporte de Hispack a la industria del envase y embalaje y, aglutinando esfuerzos se erige como fuente sectorial con la publicación en el año 2000 del **Libro Blanco del Envase y Embalaje en España** realizado en colaboración con el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. Se trata de un completo y actualizado estudio que analiza los diferentes subsectores que conforman la industria del envase y embalaje española, la normativa medioambiental, el asociacionismo, el marketing y el diseño. En definitiva, una herramienta que Hispack pone al servicio de las empresas del sector para implementar nuevas y eficaces estrategias comerciales. Con motivo de la celebración de Hispack 2003, se pre-

sentó una actualización de esta obra bibliográfica con el fin de incluir datos económicos más recientes y ofrecer un análisis más fiable de las tendencias que van a marcar el futuro de esta industria en los próximos años.

El equipo organizador

A mediados del pasado mes de enero, el Consejo de Administración de Fira de Barcelona nombró a Javier Riera-Marsa como presidente del Comité Organizador del **Salón Internacional del Embalaje, Hispack**, en sustitución de Miguel Heredia que, a su vez, pasa a ocupar el cargo de presidente del Comité Organizador del **Salón Internacional de las Industrias y Comunicaciones Gráficas, Graphispag**.

Riera-Marsa, barcelonés de 52 años, es un reconocido empresario del sector de maquinaria para envase y embalaje de productos para la industria alimentaria -principalmente café, pasta, galletas, caramelos y productos lácteos, así como en el envasado de productos secos en general-; industria farmacéutica, química y cosmética. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la actividad de su empresa familiar. Actualmente dirige las diferentes empresas del Grupo COEMBA: Representaciones IMCO, S.A.; RADAR, S.L. y MAQUINARIA DEL RHIN, S.A. Casado y con tres hijos, Riera-Marsa es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE y cuenta en su formación con un MBA también por ESADE. Asimismo, el nuevo presidente de Hispack es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta de la Asociación Graphispag.

El Comité Organizador del salón -órgano consultivo que reúne a las principales empresas, asociaciones y entidades del mundo del envase y embalaje- también ha incorporado nuevos miembros con el fin de ampliar la representatividad de todas las especialidades presentes en la oferta del salón. El Comité se ha

constituido oficialmente a comienzos del mes de junio.

El equipo de Fira de Barcelona encargado de la organización de **Hispack 2006** estará encabezado por Xavier Castells. Esta será su novena edición al frente de Hispack. Xavier Castells, barcelonés de 60 años, es director del Salón Internacional del Embalaje desde 1991. Perito industrial metalúrgico y diplomado en Dirección y Administración de Empresas, Castells ha desarrollado su extensa trayectoria profesional en el ámbito ferial, lo que le hace un gran conocedor de este sector. Vinculado a Fira de Barcelona desde 1971 (salvo un paréntesis intermedio de cinco años) es también desde el año 2000 el máximo responsable del área de salones industriales de Fira de Barcelona en la que se enclavan ferias como Graphispag, Graphintro, Serigraph, Expoquimia, Equiplast, Eurosurf, La Mostra, Expomatex y Hostelco.

Fira de Barcelona cuenta, además, con la colaboración permanente de la Asociación Graphispag que promueve la participación de empresas y la organización de actividades de interés para el sector en el salón. Asimismo, desde Fira de Barcelona se están abriendo diferentes vías de cooperación con otras asociaciones, entidades y empresas del sector para diseñar un salón a medida de las necesidades de la industria del envase y embalaje.

Hispack pasó a ser trienal

El Comité Organizador de Hispack acordó en julio de 2003 que el salón adoptara una periodicidad trienal -en vez de bienal como hasta ahora- con el fin de adaptarse a los cambios de la industria del envase y embalaje; dar respuesta a las necesidades del sector; y adecuarse al calendario internacional de salones de su especialidad.

La dilatada cadencia de presentación de novedades, sobre todo en maquinaria; los cambios producidos en el propio sector; las demandas de las empresas para poder rentabi-

lizar al máximo su participación ferial; y el calendario internacional de salones de envase y embalaje motivaron la decisión de variar la periodicidad de Hispack.

Al igual que sus homólogos europeos Interpack (Düsseldorf); Total (Birmingham) e Ipack-Ima (Milán), **Hispack** se celebrará cada tres años, lo que permitirá a las compañías europeas planificar y compaginar su asistencia -como expositor o visitante- a las ferias del sector en función de sus necesidades comerciales, evitando duplicidades o solapamientos de años.

Nuevo recinto Gran Vía M2

Como se recordará, la última edición de Hispack se celebró, por primera vez, en el recinto Gran Vía M2 de Fira de Barcelona. Este cambio de ubicación llevó asociada una mejora en la sectorización de la oferta y en la calidad de servicio tanto a expositores como a visitantes.

En el año 2006, el recinto Gran Vía M2 contará con dos nuevos pabellones, el N° 3 y N° 4 (actualmente en fase de construcción), cuya superficie, sumada a la de los dos pabellones existentes, permitirá a Hispack ocupar hasta 125.000 m² brutos de exposición.

De todos es sabido que Fira de Barcelona está ampliando sus instalaciones en el emplazamiento Gran Vía M2. De este modo, la entidad ferial catalana tendrá el recinto más moderno de Europa y, sin duda, el más relevante y atractivo por su arquitectura y urbanismo. El proyecto del arquitecto japonés Toyo Ito, ganador del concurso internacional de ideas para la ampliación del actual emplazamiento de Gran Vía, combina la espectacularidad y el respeto al medio ambiente con una eficiente y creativa respuesta a las necesidades de espacio de Fira de Barcelona, imprescindibles para seguir siendo una institución altamente competitiva y crecer de acuerdo con las demandas de espacio plan-

teadas por la organización de salones.

Datos de la última edición

La última edición del **Salón Inter-**

nacional del Embalaje se celebró del 31 de marzo al 4 de abril, con una superficie total bruta de 76.246 m² y 47.424 m² de superficie neta, y una participación de 2.177 empresas, procedentes de 32

países. De estas empresas, 737 fueron expositores directos y 1.440 presentados. La cifra total de profesionales que visitaron el Salón fue de 30.438 de los que 2.303 fueron extranjeros.

Ficha Técnica

Denominación:	Hispack 2006, Salón Internacional del Embalaje
Edición:	Decimotercera
Carácter:	Profesional
Fechas de celebración:	Del 27 al 31 de marzo de 2006
Horario:	De 10.00 a 19.00 horas
Lugar:	Recinto Gran Vía M2 (L'H) de Fira de Barcelona.
Organiza:	FIRA DE BARCELONA Av. Reina María Cristina s/n 08004 Barcelona Tel. 902 233 200 Fax 93 233 26 02 -22 99 hispack@firabcn.es
Con la colaboración de:	ASOCIACION GRAPHISPACK
Sectores:	Maquinaria y accesorios de envase y embalaje. Maquinaria y equipos de embotellado. Maquinaria para etiquetado, codificación y marcaje. Maquinaria para procesos de fabricación de productos a envasar. Materias primas. Materiales y medios de Envase y Embalaje. Productos auxiliares. P.L.V., Publicidad en el Lugar de Venta. Logística. Manipulación, almacenamiento y distribución. Medio ambiente. Recuperación, Tratamiento y Reciclaje. Empresas de Consultoría, ingeniería y servicios afines.
Otras actividades:	- "Encuentros Hispack", primer congreso científico - técnico de envase y embalaje - VI Concurso Nacional de Líderes del Envase y Embalaje, Líderpack 2006. Exposición y Entrega de Premios - V ciclo de la exposición "PACK. Historia, Memoria y Cultura del Packaging"
web:	www.hispack.com
Presidente del Comité Organizador:	Javier Riera-Marsa
Director área salones Industriales de Fira de Barcelona:	Xavier Castells

MAYOR INFORMACION: FIRA DE BARCELONA

Av. Reina María Cristina s/n - 08004 Barcelona, España

Tel.: 902 233 200 - Fax: 93 233 26 02 -22 99 - E-mail: hispack@firabcn.es - Web: www.hispack.com